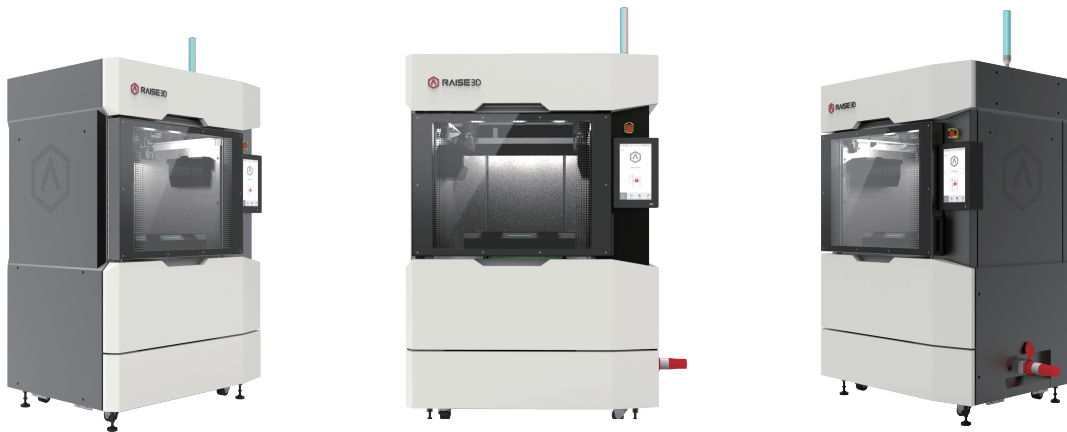


Raise3D RMF500 技术规格

触手可及的工业生产力



以大尺寸构建空间铸就高效工业生产力

Raise3D RMF500的构建空间可达500 x 500 x 500 mm，其配备独立双电动喷嘴，并采用Hyper FFF高速打印技术。RMF500是大尺寸零件制造和小批量生产领域的生产力领导者，其最大线速度达到500m/s*，最大加速度达到15,000mm/s²*，这已经超越许多普通工业级3D打印机的2倍速度。

专注于可靠性和高精度的工程设计

Raise3D RMF500专为工业级性能而设计，其拥有坚固的机械结构，包括线性电机、全钢结构框架和高负载Z轴，确保全天候精准打印。

持续高效生产的设计理念

Raise3D RMF500搭载独立双挤出头 (IDEX) 技术，可实现复制和镜像打印，极大缩短了打印时间，提升工作效率。其独特设计允许一次性装载4卷2.5公斤耗材，足以支撑至少一个完整工作周(5天)的连续正常运行。同时，自动换料和内置干密封袋的细节设计，保证了高速打印过程的连续性，无需停机。

专为高性能工业打印设计的经济解决方案

Raise3D RMF500是制造大尺寸部件、高强度工装夹具以及高性能最终零部件的品价比之选。RMF500现已加入Raise3D开放耗材计划 (OFF)，包括增强型纤维等在内的主流工程材料均有提供。RMF500不仅拥有具有竞争力的整机定价，还具备经济实惠的耗材成本和出众的能耗表现，为您提供全面而经济的解决方案。

*测试数据源自Raise3D实验室

Raise3D RMF500技术参数

打印机硬件

打印技术原理	熔丝制造技术 (FFF), 由Hyper FFF™提供
打印尺寸 (长×宽×高)	500×500×500 mm (正常打印模式下) 对角线最大长度707 mm
挤出系统	IDEX双独立电动喷头挤出系统、自动清洁喷嘴、断料检测
最高喷嘴温度	330 °C
XYZ轴步进精度	1, 1, 0.09765 micron
打印速度/加速度	最大速度500 mm/s; 最大加速度15000 mm/s ² *
打印平台	柔性底板, 磁吸固定, 打印底板自动调平
打印平台温度	最大110°C
喷嘴直径	0.4 mm (默认), 0.6 mm (即将推出)
耗材供给	耗材自动切换, 内置干燥系统

耗材

耗材	直径1.75mm, 可装载4卷1kg 或 2.5kg耗材 (2卷耗材对应1个喷嘴)
Raise3D Hyper Core耗材 (支持高速打印)	Hyper Core ABS CF15、Hyper Core PPA CF25 即将推出: Hyper Core PPA GF25
Raise3D Hyper Speed 耗材 (支持高速打印)	Hyper Speed ABS、Hyper Speed PLA
Raise3D 工业耗材	Industrial PET CF、Industrial PET Support 即将推出: Industrial PPA CF、Industrial PPA Support、Industrial PPA GF、 Industrial PET GF、Industrial PETG ESD
第三方耗材	通过验证得到开放耗材计划 (OFP) 的支持

软件和网络

连接端口	Wi-Fi、局域网、USB 端口、实时摄像头
网络	以太网, 无线网 802.11 b/g/n, 2×2无线局域网
显示屏	13.3 英寸 (33.8 cm) 彩色触摸屏 (1920×1080)
切片软件	ideaMaker
支持文件格式	STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP
支持运行系统	WINDOWS/ macOS/ LINUX

运行和运输

电源输入	三相交流电380 V AC 25 A
工作环境温度	15 - 30°C, 相对湿度30 - 70% 无结露
存储温度	-40 to 54°C, 相对湿度10 - 85% 无结露
机器尺寸(长×宽×高)	1340×990×2370 mm
重量	净重790kg 毛重1048.1kg
装运尺寸	1800×1160×2260 mm